



Mate 2009 第15回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」 シンポジウム参加者募集

主催：(社)溶接学会 マイクロ接合研究委員会
共催：(社)機械学会 エレクトロニクス実装における信頼性設計と熱制御に関する研究分科会, (社)高温学会 微細加工研究情報委員会, (社)日本塑性加工学会 接合・複合分科会, (社)日本電気制御機器工業会, エレクトロニクス生産科学学会準備会, レーザ加工学会, 大阪大学 先端科学イノベーションセンター
協賛：映像情報メディア学会, エレクトロニクス実装学会, 応用物理学会, 化学工学会, 画像電子学会, 軽金属学会, 計測自動制御学会, 高温学会, 高分子学会, 資源・素材学会, システム制御情報学会, 情報処理学会, 精密工学会, 電気化学会, 電気学会, 電気設備学会, 電子情報通信学会, 日本機械学会, 日本金属学会, 日本顕微鏡学会, 日本材料学会, 日本シミュレーション学会, 日本接着学会, 日本セラミックス協会, 日本塑性加工学会, 日本伝熱学会, 日本非破壊検査協会, 日本表面科学学会, 日本品質管理学会, 日本複合材料学会, 日本物理学会, 日本分析化学学会, 日本溶接協会, 表面技術協会, プラスチック成形加工学会

開催趣旨

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムでは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

日時：平成21年1月29日(木) 8:50～17:50
平成21年1月30日(金) 9:00～17:30

会場：パシフィコ横浜 アネックスホール
(F201～F206)
横浜市西区みなとみらい1丁目1-1

シンポジウム参加登録費(論文集代を含む)

○主催・共催団体登録会社 : 20,000円
 ○協賛学協会会員会社 : 30,000円
 ○論文口頭発表者 : 15,000円

○大学、国公立研究機関 : 10,000円
 ○学生 : 5,000円
 ○その他(一般) : 40,000円

シンポジウム参加申込方法

下記シンポジウムURLより平成21年1月20日(火)までに参加登録を行って下さい。

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2009.html>

参加費のお支払いは、銀行振込・クレジットカードのいずれかをお願い致します。

問合せ、申込先 Mate 2009 事務局 事務代行
 <参加申込>

株式会社 日本旅行
 イベント・コンベンション営業部
 TEL: 03-5565-9890, FAX: 03-5565-9611
 E-Mail: mcs_inq01@nta.co.jp

<論文および広告・カタログ>

合同会社フロンティア・アライアンス
 ものづくりリエゾンオフィス事業部
 TEL: 06-6878-5628, FAX: 06-6879-7568
 E-Mail: mate@fa-mlo.com

参加申込締切日：平成21年1月20日(火)

振込先銀行：みずほコーポレート銀行 十五号支店
 口座番号：普通3101980
 口座名：株式会社日本旅行

シンポジウム URL

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2009.html>

プログラム(セッション名と発表件数)

1月29日(木) 8:50～17:50 (18:00～懇親会)

◆プレナリーセッション

「イノベーション創出の鍵を握るシステムデザイン・インテグレーション(SD・SI)と課題」

(大阪大学 佐藤了平)

「ものづくりデジタルデザインの現状と新SD・SI手法開発状況及び今後の展開」

((株)エンジニアスジャパン 工藤啓治
 大阪大学 岩田剛治)

「エレクトロニクスシステムの鍵を握る半導体の微細化限界と3次元システムLSIの可能性と最前線」

((株)ニコン 岡本和也)

「次世代半導体の鍵を握るSipの現状と今後の展開」

((株)ルネサステクノロジ 赤沢 隆)

1月29日（木） 8:50～17:50

- [A-1] めっき・信頼性（4件）
- [A-2] 接続信頼性 I（4件）
- [A-3] 接続信頼性 II（5件）
- [B-1] フィラー実装（5件）
- [B-2] 材料・デバイス開発（4件）
- [B-3] 薄膜・レーザ加工（4件）

1月30日（金） 9:00～17:30

- [A-4] パワーモジュール（6件）
 - [A-5] 熱変形（4件）
 - [A-6] 力学信頼性（5件）
 - [A-7] 疲労・熱疲労（4件）
 - [B-4] MEMS- I（講演2件＋論文2件）
 - [B-5] MEMS- II（講演1件＋論文3件）
 - [B-6] MEMS- III（5件）
 - [B-7] MEMS- IV（4件）
 - [C-4] 材料・界面反応（6件）
 - [C-5] 固相接合（5件）
 - [C-6] エロージョン I（講演2件＋論文2件）
 - [C-7] エロージョン II（3件）
- （一般論文発表合計75件）